

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2021-003

深圳市杰普特光电股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”或“杰普特”）于2021年1月6日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于深圳市杰普特光电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下：

一、 募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1797号《关于同意深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股23,092,144股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.86元，共募集资金人民币1,012,821,435.84元，扣除发行费用97,785,759.07元，实际募集资金净额为人民币915,035,676.77元。以上募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2019]48490002号《关于深圳市杰普特光电股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公

公司及全资子公司惠州市杰普特电子技术有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见 2019 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

（二）募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额	募集资金投资额	预计达到可使用状态日期	已投入费用	已投入费用与总计划投入费用百分比
1	光纤激光器扩产建设项目	惠州杰普特	13,151.00	12,371.00	2021 年 6 月 30 日	4,904.39	37.29%
2	激光/光学智能装备扩产建设项目		11,987.00	11,276.00	2020 年 9 月 30 日	5,227.13	43.61%
3	半导体激光器扩产建设项目		9,837.00	9,253.00	2020 年 12 月 31 日	1,622.31	16.49%
4	半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目		16,753.00	15,759.00	2020 年 12 月 31 日	1,966.80	11.74%
5	超快激光器研发生产建设项目		8,859.00	8,333.00	2021 年 12 月 31 日	1,558.00	17.58%
6	研发中心建设项目		7,689.00	7,233.00	2022 年 12 月 31 日	2,408.82	31.33%
7	补充流动资金		29,000.00	27,278.57	-	27,278.57	100.00%
	合计		97,276.00	91,503.57	-	44,966.03	-

注：1、上表“已投入费用”、“已投入费用与总计划投入费用百分比”为截至2020年12月24日的统计数据，该数据未经审计；

2、上表各分项加总金额与合计数不一致系由于四舍五入导致。

截至 2020 年 12 月 24 日，公司首次公开发行募集资金存放专项账户的存款

情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
兴业银行股份有限公司深圳分行	337080100100686910	活期存款	98,413,914.30
上海浦发银行股份有限公司深圳分行	79100078801000000773	活期存款	130,021,994.08
北京银行股份有限公司深圳分行	20000030960300031288016	活期存款	95,882,578.07
中国民生银行股份有限公司深圳分行	631519345	活期存款	80,299,504.72
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	741973024981	活期存款	62,973,475.61
	753672851199 ^注	活期存款	9.64
中国银行股份有限公司惠州仲恺支行	683472525826	活期存款	17,466,009.90
合 计	-	-	485,057,486.32

注：该账户为母公司募集资金专户，母公司募集资金专户是按照《募集资金专户存储三方监管协议》设立的募集资金专户，截至2020年12月24日余额9.64元为结余银行存款利息收入。

截至2020年12月24日，公司已累计使用募集资金44,966.03万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金余额为48,505.75万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、 本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

募集资金投资项目		预计可使用状态日期
半导体激光器扩产建设项目	变更前	2020年12月31日
	变更后	2022年6月30日
激光/光学智能装备扩产建设项目	变更前	2020年9月30日
	变更后	2021年9月30日
半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目	变更前	2020年12月31日
	变更后	2022年6月30日

（二）本次部分募投项目延期的原因

公司募投项目“半导体激光器扩产建设项目”、“激光/光学智能装备扩产建设项目”、“半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目”均在惠州仲恺区自行建设场地内实施。该场地原计划工程建设周期一年半，于2020年6月30日前达到预定可使用状态。2019年项目实施场地建设打地基期间遇到雨季，导致建设周期延误两个月；2020年受新冠疫情影响，厂房建设工人无法及时按原定计划到位，导致工程建设实施进度放缓。公司原预计工程建设将推迟3个月完工，但由于首次建设激光器生产老化工序使用的集中式冷却系统工程，该工程较分散式冷却系统工程工作量大，需在建筑本体进行整体布线，并在建筑物顶部加建冷却塔，公司对供应商招标选型时间较预期长约2个月；此外，由于住房城乡建设部实施新的消防验收技术标准不久，建筑工程设计公司对标准理解存在偏差，导致相关工程报建审核通过时间较预期长约2个月，公司现预计2021年3月31日前该场地工程建设达到预定可使用状态。

除上述工程建设延误原因外，受新冠疫情影响，“半导体激光器扩产建设项目”所需设备的采购交付周期由2-3个月延至6-8个月；因半导体激光器生产所需场地洁净度要求高，千级无尘车间建设时间较其他募投项目更长；同时，受上述疫情及高场地洁净度要求影响，负责该项目的大多数研发人员无法按原计划回到公司从事研发工作，居家办公方式不适用于该募投项目，导致该项目研发进度较原计划延误约3个月；此外，因半导体激光器产品发展更新迭代速度较快，公司将视研发进度分阶段采购设备、招聘人员、释放产能，以保证产品的竞争力。综上，公司将“半导体激光器扩产建设项目”的建设期延长1.5年，即达到预定可使用状态时间调整至2022年6月30日。

“激光/光学智能装备扩产建设项目”因上述场地建设延期及采购周期延长影响，公司将“激光/光学智能装备扩产建设项目”的建设期延长1年，即达到预定可使用状态时间调整至2021年9月30日。

截至目前，“半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目”募投项目工程建设阶段已基本完成。除上述场地建设延期原因及采购周期延长原因外，近期公司激光/光学智能装备事业部紧急订单较多，部分客户集中在本年年末、明年年初期间确定产品供应商及采购数量。公司激光/光学智能装备研发、管理及部分生产人员均投入在订单交付及产品研发改进工作中，导致对于募投项目推进

进度较原计划缓慢。综上，公司将“半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目”建设期延长 1.5 年，即达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 6 月 30 日。

三、 重新论证募集资金投资项目

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》相关规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%”，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此公司对上述项目进行了重新论证。

（一）半导体激光器扩产建设项目

1、项目建设的必要性

（1）强化核心零部件自产能力

半导体激光器具有体积小、结构简单、输入能量低、寿命较长、易于调制以及价格较低廉等优点，在光电子领域中应用非常广泛。半导体激光器作为光纤激光器和固体激光器的泵浦光源，是光纤激光器和固体激光器最关键、基础的核心器件之一。半导体激光泵浦的光纤激光器和固体激光器，具有总体效率更高、功率更高、系统寿命更长等优点。

本项目建成后，一方面公司业务将进一步延伸至上游核心零部件的半导体激光器业务领域，丰富公司激光器产业链；另一方面将打破公司在核心零部件方面依赖外购的情况，有效控制器件成本和质量，同时有利于为公司未来发展半导体激光器的各类应用打下基础，提升公司的整体技术实力与盈利能力。

（2）把握半导体激光器市场发展趋势，提升市场占有率

基于光纤激光器和固体激光器的快速发展所带来的需求，以及材料加工、医疗美容等半导体激光器直接应用领域的进一步发展，半导体激光器应用市场需求空间日益广阔。

从我国的激光器市场趋势来看，半导体激光器是国家战略新兴产业重点产品的鼓励发展对象之一，国家发改委 2017 年 1 月发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》，明确将半导体激光器件、高性能全固态激光器件、光纤激光器件、固态激光材料、高端电子专用测量仪器等产品列入目录。我国在高功率半导体激光器的研制和生产技术已有了一定基础和实力，但与国际

先进水平相比，仍存在较大的差距，特别是在半导体激光器的核心部件——半导体激光芯片的研制和生产方面，一直受外延生长技术、腔面钝化技术以及器件制作工艺水平的限制，使得国产半导体激光器件的功率、寿命方面较之国外先进水平尚有较大差距。这导致国内工业用或商用高功率、长寿命半导体激光芯片主要依赖于进口，半导体激光器系统的价格居高不下，影响大功率半导体激光器在我国的推广应用，同时也限制了我国高功率光纤激光器的研制和开发。

公司基于自身激光器研发生产技术积累，切入半导体激光器这一核心零部件的研发生产，加大对半导体激光器的研发生产投入，有助于公司把握半导体激光器产业的市场发展趋势，深化公司在激光器产业生产与应用领域的业务深度，提升市场占有率。

2、项目可行性分析

(1) 核心技术储备雄厚

公司作为业内领先的激光器厂商，2017 年以来对半导体激光器的产品技术功能、生产工艺流程、成品检测应用等进行实践探索，且已初步实现生产及技术积累。本项目所涉及的半导体激光器产品的技术研发及生产建设，是基于公司致力于打造在激光器全产业链研发制造能力的战略基础上，结合已有激光器核心技术的产业化转化所确立的，有利于解决半导体激光器产品生产过程中可能出现的技术难题，提高半导体激光器的产品成品率及合格率。

(2) 科研项目管理经验丰富，科研攻坚成功率较高

公司深耕激光器行业多年，逐渐构建了专业水平过硬、涉足领域广泛、项目实操经验丰富的核心研发团队，并配备了以研发总监为主导的半导体激光器研发制造队伍，专责半导体激光器产品领域的研发、制造、生产等关键环节。公司现有核心科研团队、管理人员及专门化的研发制造团队，能够支撑本项目建设过程中的核心器件研发、整机组装、流程测试、人员培训等工作以及运营期的各项生产管理工作，为本项目的顺利实施提供重要保障。

3、募投项目经济效益测算

项目名称		年均净利润	税后内部收益率	税后静态回收期
半导体激光器扩产建设项目	变更前	2,052 万元	21.76%	6.2 年
	变更后	1,277 万元	12.82%	9.2 年

（二）激光/光学智能装备扩产建设项目

1、项目建设的必要性

（1）布局激光/光学智能装备领域，抢占潜力产业制高点

激光制造装备具有高效率、无污染、高精度等优点，已成为高精尖产业制造的必备设备。激光/光学智能装备是符合未来先进激光制造技术与工业 4.0 产业升级的关键设备之一，它以各类激光器为核心模块，结合传感技术、智能控制及自动化技术，对新型材料和器件进行高精度材料处理和检测。

公司将持续开发激光调阻机、特殊材料切割设备及高精度智能光谱检测机。该类激光/光学智能装备在高性能贴片元器件精密微加工，以及硅晶圆、OLED 柔性显示屏、蓝宝石玻璃等材料的精密切割和光谱特性分析、材料特性分析等领域拥有广泛的应用前景。公司将通过对激光/光学智能装备的集成应用进行研究，争取于国内激光/光学智能装备产业快速发展期，抢占高增长潜力产业的制高点。

该项目的成功实施，将持续夯实公司智能装备研发、配套软件开发、运行环境集成等核心技术能力。同时，公司对国内激光/光学智能装备市场的抢先布局，利于装备类产品的长期发展，逐步积淀的技术优势将支撑公司未来发展激光/光学智能装备的高端品类，提升装备类产品的利润水平，为公司带来持续、稳定的利润贡献。

（2）契合公司战略发展，打造多产品价值变现体系

公司致力于成为杰出的激光器和激光/光学智能装备全球解决方案提供商，公司通过该项目建设将大力拓展激光/光学智能装备产品市场，与现有高端用户开展深入紧密的研发及商务合作，为客户提供基于激光光源技术的激光/光学智能装备解决方案。公司将在激光光源自主研发的基础上，实现机械系统集成、软件应用开发、电控精密协作等的整合与共享，进而为其自身带来增量业务机会并提升盈利能力，有助于公司构筑业务多元化发展新模式下的多产品体系，增强市场竞争能力。

（3）新建激光/光学智能装备生产基地，提升产能以夯实业务发展

近年来，随着激光产业的高速发展以及公司光纤激光器和激光/光学智能装备在市场上认可度的进一步提升，公司激光/光学智能装备销售规模迅速增长，预计公司现有生产场地、人员配置、配套设备等将难以支撑未来的激光/光学智

能装备订单规模。考虑到公司近年来主营业务发展趋势向好，本项目新设激光智能调阻机、特殊材料切割设备及专用品牌定制设备的流水生产线，能够有效提升公司产能水平，为业务持续增长奠定基础。

2、项目可行性分析

(1) 技术团队人才雄厚，科研能力水平行业领先

激光/光学智能装备作为激光产业领域内的高端设备，具有较高的技术门槛。激光/光学智能装备能否成功打开应用市场，生产厂家的科研能力和技术水平起到了决定性作用。公司拥有专业的科研团队、优秀科研能力和新产品开发能力，是公司优势体系形成的关键驱动因素。目前，杰普特已经构建了一支以总经理刘健博士、副总经理成学平博士、研发总监刘猛博士、制造总监赵崇光博士、技术支持总监刘明先生等员工为核心的科研团队，团队成员来自于国内外知名院校，专业涉及物理电子学、光纤激光器、光纤光学、电子工程、凝聚态物理等，团队的专业水平高、涉及领域广、项目实践经验丰富。近年来，公司加大研发力度，已积累了包括激光调阻机系统方案、高速光谱检测技术等在内的核心技术以及多项软件著作权。

此外，公司与国内外知名科技企业、著名高校以及政府等开展长期业务合作和针对性的业务研发，提高了公司在激光器和激光智能设备领域的研发生产能力。公司为广东省大功率光纤激光器工程技术研究中心、深圳市大功率光纤激光器工程技术研究开发中心、深圳市博士后创新实践基地、深圳市“孔雀计划”实施单位，可以为项目实施提供充足支持。

(2) 精品客户群体合作黏性高，品牌示范作用奠定业务基础

激光/光学智能装备下游的需求企业多为电子元件制造、光学元件制造、3C电子、汽车电子、半导体制造等行业的厂商，其设备供应商较为稳定，通常为长期合作伙伴关系。若要新开辟激光/光学智能装备市场，除产品具有较为优良的产品性能和可靠的质量以外，还需较为稳定的客户群体，进入知名企业的设备供应商名录为公司挖掘新客户提供品牌示范作用。

公司已精耕光纤激光器和装备领域十余年，公司凭借优秀的研发能力、可靠的产品质量和优质的服务不断扩大客户资源储备。公司积累了包括苹果公司、海目星激光、中兴、华为、国巨股份、厚声电子等在内的大量优质客户，此类客户

多数为电子元件制造、光学元件制造、3C 电子设备制造、激光加工装备、半导体制造等行业的领先企业，普遍具有较高的合作黏性，业务发展可持续性高，部分核心优质客户更是公司长期合作伙伴。

(3) 质量控制体系完善，有效保障生产效能

公司完善的质量控制体系实现了对生产环节风险控制的有力保障。为了防止生产环节出现引起产品失效的问题，公司制定了一整套完善的生产管理与质量控制体系，包括《生产车间管理制度》、《生产管理程序》、《制程管理程序》、《成品检验管理程序》、《来料检验管理程序》、《内部品质稽核程序》等制度体系。各项制度的充分落实有效提高了激光/光学智能装备生产环节效率和产品品质。

3、募投项目经济效益测算

项目名称		年均净利润	税后内部收益率	税后静态回收期
激光/光学智能装备扩产建设项目	变更前	6,083 万元	51.10%	3.6 年
	变更后	4,580 万元	31.18%	5.3 年

(三) 半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目

1、项目建设的必要性

(1) 丰富公司智能装备产品结构，满足半导体产业旺盛需求

现如今，半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路，半导体集成电路产品作为信息产业当中最核心的微观部件，在工业自动化、消费类电子、汽车电子、通讯电信、照明电路等领域应用广泛。半导体产业下游市场需求旺盛，上游市场的产品市场规模保持着持续上行的趋势。

本项目的建设主要为研发生产半导体检测设备和以晶圆段精密加工设备、IC 模组段精密加工设备和脆性材料精密加工设备为主的半导体激光加工设备，属于公司激光智能装备业务的拓展方向。因此，本项目建设，一方面可使公司在集成电路和半导体光电相关器件精密检测及加工方面的技术更为专业化，优化智能装备业务的产品结构；另一方面，可有效迎合半导体良好的发展趋势，满足半导体市场的旺盛需求，从而提升公司高端装备产品的在半导体产业领域的市场规模与盈利水平。

(2) 响应国家智能装备利好政策，提升高端激光装备技术水平

激光装备因其具有精度高、自动化、高效率等加工优势，已经渗透到 3C 家

电、电子、机械、医疗、国防等领域的研发、生产、检测的过程中，多种光源技术和应用系统广泛应用，激光装备产业已逐渐成为现代国家制造业领域最为重要的上游产业之一。目前，在我国激光装备领域，通用型标准化激光装备已基本实现国产化。随着近年来国家对智能制造关键部件的政策倾斜，越来越多的科研单位及部分企业开始加大投入，并且在科研及产业化上取得了较大进步，与该领域国外相关企业的差距逐步缩小。但另一方面，对于非标定制化装备、自动化程度较高的激光智能装备、半导体及特殊材料所用的激光装备，国产品牌的占有率则较低。

近年来，国家出台多项政策加大对激光制造装备产业的扶持力度，并引导产业升级。2016年7月，国务院发布《“十三五”国家科技创新规划》，提出开展超快脉冲、超大功率激光制造等理论研究，突破激光制造关键技术，研发高可靠长寿命激光器核心功能部件、国产先进激光器以及高端激光制造工艺装备，开发先进激光制造应用技术和装备。2016年12月，工信部、财政部发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，明确将智能加工装备列为战略新兴产业重点产品，而激光装备正属于此政策鼓励的重点产品。

公司本项目的建设主要为研发生产半导体检测设备和以晶圆段精密加工设备、IC模组段精密加工设备、激光清洗设备和脆性材料精密加工设备为主的半导体激光加工设备，上述设备皆属于半导体产业领域的高端设备。随着传统产业的技术升级、产业结构调整、节能环保政策的推出以及产品个性化需求趋势的发展，激光智能装备将越来越多向定制化方向发展，而半导体激光加工设备作为激光智能装备的重要组成部分，产业应用前景以及设备迭代需求巨大。因此，结合公司在高端装备领域的技术积淀与业务发展需要，本项目实施具有必要性。

（3）完善激光加工领域技术布局，提升潜力产业市场渗透率

近年来，中国的消费电子、智能装备、PCB、机器人、人工智能、LED激光加工等领域的发展迅猛，上述领域皆对半导体的加工精密程度有着较高的要求，尤其是在半导体加工关键环节，皆需采用高精密性的激光加工设备，以求更精细、更稳定的产品质量。

随着半导体激光加工设备技术的持续迭代与升级，半导体激光加工设备的价值逐步显现，其将有序渗透3C设备、电子、机械、医疗、国防等领域，未来发

展空间宽广。然而，囿于半导体激光加工设备涉猎领域较广、技术门槛相对较高，其整体市场成熟度不足且各细分领域的市场集中度较低。基于此，公司凭借在激光器与激光智能装备多年的实操经验，整合原有的光源研发、平台搭建、应用集成等专业基础，生产半导体检测设备、晶圆段精密加工设备、IC 模组段精密加工设备和脆性材料精密加工设备等高端半导体激光加工设备。由此，公司将通过延伸主业的技术与服务，对半导体激光加工设备的集成应用进行研究，构建自身于半导体激光加工设备产业的激光光源应用、整机系统集成等核心业务能力，争取于半导体激光加工设备产业成熟度较低之际，提升在此潜力产业当中的渗透程度。

本项目的成功实施，将夯实公司于激光光源应用、整机系统集成等技术能力，有效反哺主营业务。此外，公司对国内半导体激光加工领域的抢先布局，利于该业务的长期发展，逐步积淀的技术优势将支撑公司未来发展半导体激光加工设备的高端业务，为公司带来持续、稳定的增量利润贡献。

2、项目可行性分析

(1) 核心技术团队及其领先的科研能力水平是保障项目产品质量的首要条件

半导体激光加工设备与半导体检测设备作为半导体产业领域内的高端设备，能够应用于半导体晶片以及 IC 模组的标记、切割、划线、清洗等精细化加工检测领域，具有较高的技术门槛。产品能否成功打开应用市场，生产厂家的科研能力和技术水平起到了决定性作用。而公司专业的科研团队及其科研能力水平，正是公司优势体系形成的关键驱动因素。

(2) 丰富的客群合作经验与品牌示范作用是本项目产能消化的重要支撑

由于半导体激光加工设备与检测设备的下游需求企业多为机械、3C 设备、电子元件、光学元件制造等行业的领先公司，其设备需求较为高端，且设备供应商较为稳定，通常为长期合作伙伴关系。若要新开辟半导体激光加工设备与检测设备市场，除公司产品需要具有较为优良的产品性能以外，还需较为稳定的潜在客户群体，进入知名企业的设备供应商名录也能为公司挖掘新客户提供品牌示范作用。

成立至今，杰普特已精耕激光器、激光/光学智能装备、光纤器件领域十余

年，公司凭借标准化、可复制的生产模式及可靠的质量和优质的服务不断扩大各领域客户储备。公司现有优质客群具备较高的长期合作粘性、大规模的装备采购需求及稳定的付费能力，能够为本项目的产能消化提供客源基础，降低本项目的营销成本。此外，优质客户群强大的品牌示范作用，将为增量客户资源的积累及产品在半导体产业的有效渗透提供保障。

(3) 成熟的装备制造能力与生产质量控制体系是项目生产效能的有力保障

半导体激光加工设备与检测设备作为激光加工领域的高精尖设备，其所集成的光学系统、机械系统、电控系统之间的联动耦合直接决定装备的精细化程度，最终体现为所处理样件的品质效果。在此背景下，有效把控本项目所产设备的生产制造环节，是公司保障产品质量的关键所在。

一方面，作为公司负责本项目实施的智能装备事业部，已拥有多年的智能装备研发生产经验。公司所研发生产的智能光谱检测机、激光调阻机、芯片激光标识追溯系统等智能装备产品，成功实现对外销售。半导体激光加工设备与检测设备作为公司智能装备事业部新的产品拓展方向，将继承公司在智能装备研发制造方面的技术经验，加快产品研发与生产的速度，保障项目的顺利实施。

另一方面，公司完善的质量控制体系、巡查稽核制度是实现了对生产环节风险控制的有力支撑。为了防止生产环节产生引起产品失效的问题发生，杰普特制定了一套完善的生产管理与质量控制体系，包括《生产车间管理制度》、《生产管理程序》、《制程管理程序》、《成品检验管理程序》、《来料检验管理程序》、《内部品质稽核程序》等制度体系。各项制度的充分落实对有效提高激光智能装备的精密程度、大幅降低生产环节引发产品失效风险均具有积极意义。

3、募投项目经济效益测算

项目名称		年均净利润	税后内部收益率	税后静态回收期
半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目	变更前	9,611 万元	47.20%	4.4 年
	变更后	7,075 万元	28.42%	7.0 年

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的

实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况下做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况下做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司将募集资金投资项目“半导体激光器扩产建设项目”的建设期延长1.5年，即达到预定可使用状态时间调整至2022年6月30日，将“激光/光学智能装备扩产建设项目”的建设期延长1年，即达到预定可使用状态时间调整至2021年9月30日，将“半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目”的建设期延长1.5年，即达到预定可使用状态时间调整至2022年6月30日。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

公司本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情

况做出的决定，涉及延期的募集资金投资项目的可行性、必要性及预计经济效益已经公司论证，延期项目符合公司实际经营情况、业务发展战略和行业发展趋势，具有可行性、必要性，项目收益预计假设和方法合理；延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

（一）深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

（二）中国国际金融股份有限公司关于深圳市杰普特光电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2021年1月7日